1-1470364-1 V AKTIV

HPI

Interne TE-Nummer 1-1470364-1

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 11 Position, 1 mm [.039 in]

Centerline, Crimp, 1 Row, White, Wire & Cable, Power & Signal, HPI

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse > AMP HPI 1.0 mm Receptacle Housings











Produkttyp des Steckverbinders: **Gehäuse**Steckverbinder- und Gehäusetyp: **Buchse**Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: 11
Raster: 1 mm [.039 in]

Alle AMP HPI 1.0 mm Receptacle Housings (15)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp des Steckverbinders	Gehäuse
Steckverbinder- und Gehäusetyp	Buchse
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale	
Anzahl von Positionen	11
Zeilenanzahl	1
Elektrische Kennwerte	
Arbeitsspannung	50 VAC
Kontaktmerkmale	
Kontaktaufbau	Verbindungsmuffe



Kontakttyp	Stecksockel
Kontaktnennstrom (max.)	1 A
Klemmenmerkmale	
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik	
Zugentlastung	Ohne
Panelmontagevorrichtung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Art der Steckverbindermontage	Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale	
Gehäuseeingangskonfiguration	Beide Enden geschlossen
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast
Raster	1 mm[.039 in]
Gehäusefarbe	Weiß
Abmessungen	
Steckverbinderlänge	14 mm[.551 in]
Steckverbinderhöhe	2.8 mm[.11 in]
Steckverbinderbreite	5 mm[.197 in]
Drahtgröße	32 – 28 AWG
Verwendungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	55 – 105 °C[131 – 221 °F]
Betrieb/Anwendung	
Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
Industriestandards	
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmenge	24000
Verpackungsmethode	Bag

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>



EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2020 (209) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile





Auch serienmäßig | HPI





Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(2)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(139)

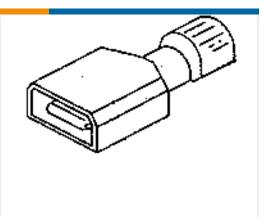


Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (362)

Kunden kauften auch diese Produkte







TE Teilenr.:2-521192-2 ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR







Dokumente

Produktzeichnungen

1.0MM W T B RECPT,11POSHOUSING

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1470364-1_R_c-1-1470364-1-r.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1470364-1_R_c-1-1470364-1-r.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1470364-1_R_c-1-1470364-1-r.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

Datenblätter/ Katalogseiten

HPI Connectors QRG

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 11 Position, 1 mm [.039 in] Centerline, Crimp, 1 Row, White, Wire & Cable, Power & Signal, HPI

